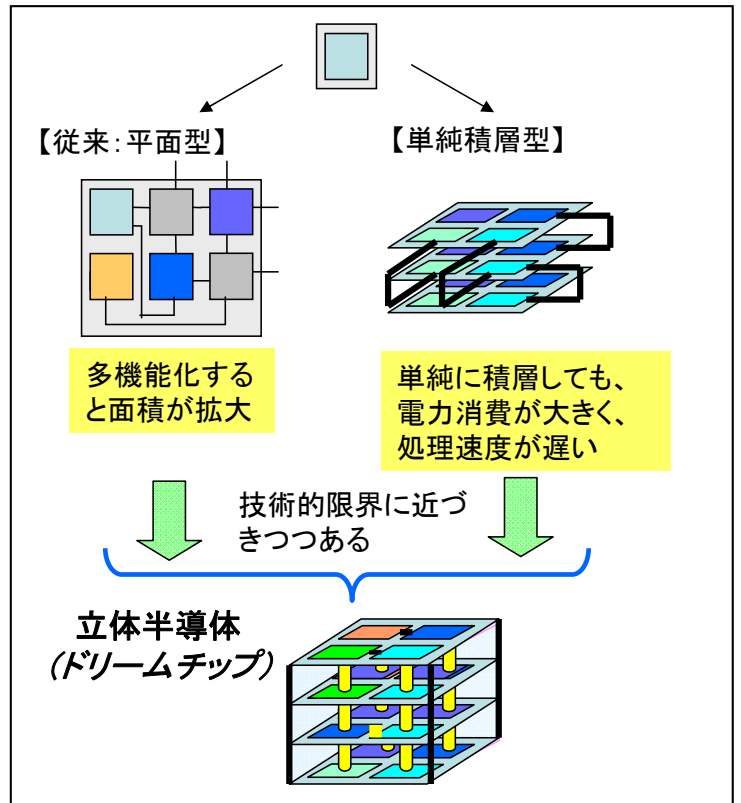


施策名： ドリームチップ開発プロジェクト 【経済産業省】

平成20年度対象予算： 1,200百万円
 (平成20年度新規)
 実施期間： 平成20～24年度
 (予算総額： 6,000百万円)

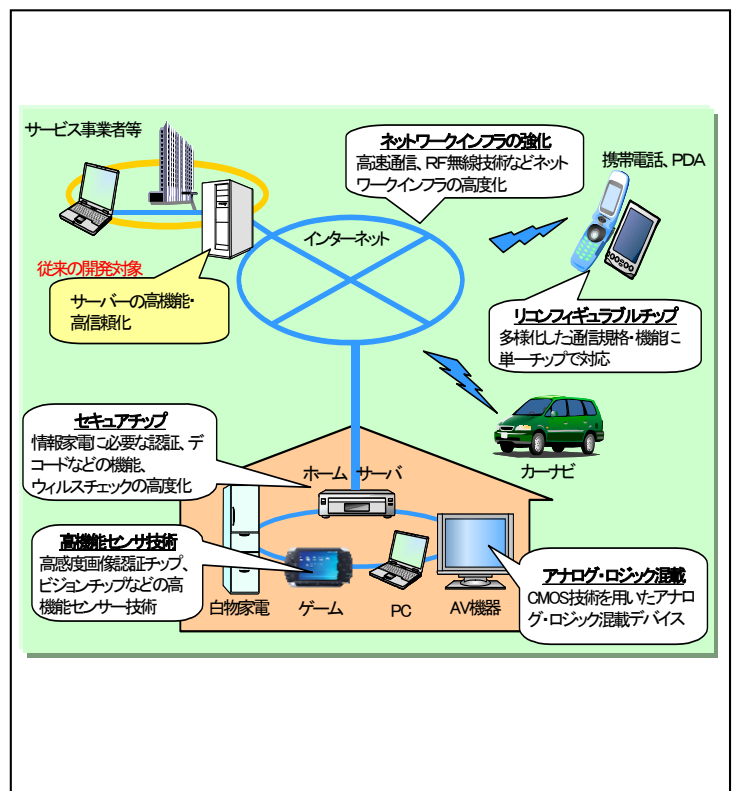
○将来の様々な社会・生活のニーズに応えられる高機能な半導体実現のため、立体構造化技術を発展・統合し、これまでにない革新的な半導体(ドリームチップ)の開発を行う。
 ○具体的には、①多機能高密度3次元化技術、②微小機械駆動形成技術(複数周波数対応通信デバイス)、③回路の書き換え可能な超小型フレックス半導体デバイスの開発を行う。



施策名： 半導体アプリケーションチッププロジェクト 【経済産業省】

平成20年度対象予算： 1,400百万円
 (平成19年度対象予算： 1,978百万円)
 実施期間： 平成15～21年度
 (予算総額： 16,181百万円)

○情報家電等の低消費電力化、高度化を実現するための低消費電力・多機能半導体チップについて提案公募を行い、採択された半導体チップの開発を支援する。



戦略重点科学技術(4)

世界トップを走り続けるための ディスプレイ・ストレージ・ 超高速デバイスの中核技術

戦略重点科学技術(4) 世界トップを走り続けるためのディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの中核技術

施策名： 高機能・超低消費電力コンピューティングのためのデバイス・システム
基盤技術の研究開発【文部科学省】

平成20年度対象予算：425百万円
(平成19年度対象予算：525百万円)
実施期間：平成19～23年度
(予算総額：2,750百万円)

OPCの高機能・低消費電力化を両立させるためには、従来のデバイス技術の延長では限界が到来。

○そのため、革新的な高機能・超低消費電力デバイスにより、高機能コンピューティングを実現させる技術基盤を確立するため、以下のブレークスルーが必要な技術について一体的に研究開発を実施する。

- (1) 超高速・多機能スピンドバイスの開発
- (2) 高速大容量ストレージシステムの開発

等

